

(19) Japan Patent Office (JP)

(12) Publication of Utility Model Application (U)

(11) Japanese Utility Model Unexamined Publication No.

1983-166070

(43) Date of Publication of Application: November 5, 1983

(51) Int. Cl.<sup>3</sup> :

H05K 3/28

1/02

3/24

(21) Application Number S57-63586

(22) Application Date: April 30, 1982

(71) Applicant: Shinnippon Denki Corporation

1-8-17, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi

(72) Deviser: AKAZAGI SHINICHI

c/o Shinnippon Denki Corporation

1-8-17, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi

(54) [Title of the Invention]

PRINTED WIRING BOARD

[Claim 1]

A printed wiring board, wherein in resist applied between conductors for soldering and fixing a passive element part, a small hole-like adhesive application point reaching a board is provided to pass through a resist layer corresponding to the mounting position of the part.

[Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 is a front section showing that a part is mounted on a printed wiring board according to the prior art; Fig. 2 is a front section showing a drop of an adhesive according to the prior art; Fig. 3 is a front section showing that a part is mounted on a printed wiring board in an embodiment of the invention; and Fig. 4 is a front section showing the drop state of an adhesive in the present invention.

In the drawings, the reference numerals designate the followings.

1: board 2: conductor 3: resist 4: part 5: adhesive  
7: application point 8: small hole

⑨ 日本国特許庁 (JP)  
 ⑩ 公開実用新案公報 (U)

⑪ 実用新案出願公開

昭58—166070

⑫ Int. Cl.<sup>3</sup>  
 H 05 K 3/28  
 1/02  
 3/34

識別記号 庁内整理番号  
 7216—5F  
 6465—5F  
 6810—5F

⑬ 公開 昭和58年(1983)11月5日  
 審査請求 未請求

(全 1 頁)

⑭ プリント配線板

⑮ 実願 昭57—63586  
 ⑯ 出願 昭57(1982)4月30日  
 ⑰ 考案者 赤崎真一

⑱ 実用新案登録請求の範囲

受動素子部品を半田付固定するための導体間に塗布されるレジスト中に、前記部品の取り付け位置に対応し、基板に達する小孔状の接着剤塗布ポイントをレジスト層を貫通して設けてなるプリント配線板。

図面の簡単な説明

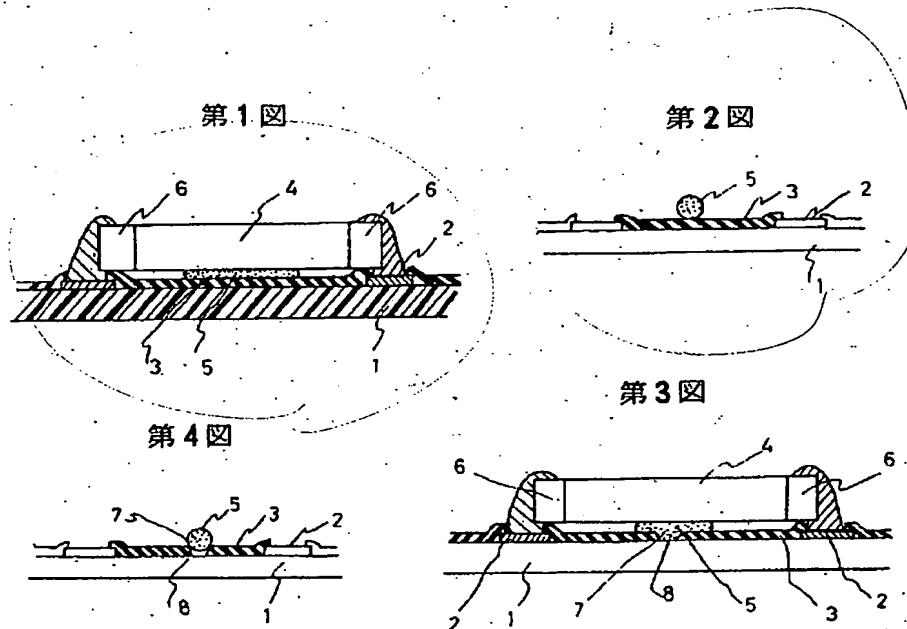
第1図は従来の部品をプリント配線板に取りつ

大阪市北区梅田1丁目8番17号  
 新日本電気株式会社内

⑲ 出願人 新日本電気株式会社  
 大阪市北区梅田1丁目8番17号

けた正断面図、第2図は従来の接着剤の滴下を示す正断面図、第3図は本考案の実施例における部品をプリント配線板に取りつけたときの正断面図、第4図は本考案における接着剤の滴下状況を示す正断面図である。

なお、図面に記載の記号は下記のものを示す。  
 1…基板、2…導体、3…レジスト、4…部品、  
 5…接着剤、6…塗布ポイント、8…小孔。



BEST AVAILABLE COPY